



חברת זיילינקס TSMC עם פעולה שיתוף על הכריזה (FPGA), המתכנתים הרכיבים מפתחת (Xilinx), בתהליך 7 נומטר וטכנולוגיית מעגלים משולבים תלת-ממדיים עבור הדור הבא של מעגלים משולבים מסוג (3D-ICs) ממדיים-תלת משולבים ומעגלים (MPSoC) מעבדים מרובות שבב-גבי על מערכות, FPGA.

הטכנולוגיה מייצגת את הדור הרביעי ברציפות, בו שתי החברות עובדות יחדיו על תהליכי שבבים מתקדמים וטכנולוגיית 3D CoWoS (Substrate-on-Wafer-on-Chip). המוצרים יהוו את הדור הטכנולוגי הרביעי של על המבוסס שונות שבבים טכנולוגיות בין במעבר יתרון לזיילינקס יספק הפעולה שיתוף FinFET TSMC. מוצרים מעולים, יכולת הביצוע, והצלחת הרכיבים בטכנולוגיות של 16, 18 ו-20 נומטר. זיילינקס מתכננת להשיק את מוצרי ה-7 נומטר ב-2017.

משה גבריאילוב, נשיא ומנכ"ל זיילינקס העולמית: שלנו להצלחה הבסיס את מהווה TSMC " בטכנולוגיות של 16, 18 ו-20 נומטר. טכנולוגיית השבבים היוצאת מן הכלל שלהם, טכנולוגיית התלת-ממד ושרותי הלקוח אפשרו לזיילינקס לבנות מוניטין חסר תחרות בתחום מצוינות המוצרים, האיכות, הביצוע והנובלה בשוק השבבים. בנוסף, הם אפשרו לזיילינקס להרחיב את מגוון המוצרים שלה עם דור חדש של "FPGA-ה מוצרי את המשלימים 3D IC ו-MPSoCs, SoCs.

מארק ליו, נשיא ומנכ"ל משותף TSMC עם הפורה הפעולה בשיתוף להמשיך שמחה TSMC " : זיילינקס ותאפשר את הדור הרביעי של מוצריה פורצי הדרך. שיתוף הפעולה בין החברות יביא דור חדש של סקאלביליות ויתרונות אינטגרציה תלת-ממדיות".

{loadposition content-related}